

证券代码：301611

证券简称：珂玛科技

## 苏州珂玛材料科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-001

<b>投资者关系活动类别</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研	<input type="checkbox"/> 分析师会议
	<input type="checkbox"/> 媒体采访	<input type="checkbox"/> 业绩说明会
	<input type="checkbox"/> 新闻发布会	<input type="checkbox"/> 路演活动
	<input type="checkbox"/> 现场参观	
	<input type="checkbox"/> 其他 <u>(请文字说明其他活动内容)</u>	
<b>参与单位名称及人员姓名</b>	中信建投孙芳芳，银华基金方建，南方基金郑晓曦；兴全基金张荣朗沐，姚丹丹，曹娜、程卿云，李君	
<b>时间</b>	2026年1月9日	
<b>地点</b>	公司会议室	
<b>上市公司接待人员姓名</b>	董事长刘先兵，董事会秘书仇劲松	
<b>投资者关系活动主要内容介绍</b>	<p>1、请问珂玛科技发行可转换债券的进展情况如何？目前公司对于有关产品的产能准备情况如何？</p> <p>答：目前，公司发行可转换债券的计划已经深圳证券交易所受理，并处于审核过程中，公司正在积极稳步推进该项目的进展。同时，公司业已完成向江苏省苏州市高新区区政府购买项目用地的相关手续。在2025年度，公司的产能建设着眼于IPO募投项目的先进材料生产基地项目逐步投产，将原先利用租赁的场地建设的陶瓷加热器工厂以及分散在其他工厂的陶瓷加热器相关设备搬迁到先进材料生产基地，并建设陶瓷加热器专用净化设施，以提高陶瓷加热器产品的生产及交付能力。</p> <p>公司发行可转换债券项目的计划将重点建设静电卡盘生产线，并扩建陶瓷加热器产能，以满足我国半导体设备关键零部件国产替代需求。</p>	

2、珂玛科技的陶瓷加热器产品与国际同类产品相比在性能、效率、稳定性水平有哪些差距？

答：自 2023 年第四季度开始批量交付陶瓷加热器产品以来，公司的高性能陶瓷加热器产品已经大批量应用于终端客户晶圆生产的薄膜沉积关键工艺生产过程中发挥重要作用，其性能达到终端客户的使用要求。公司将继续加强在陶瓷加热器方面的研发，保持与重点客户紧密的合作关系，根据实际使用情况及客户反馈和严格要求，进一步优化改进材料配方、生产流程和质量控制，开发生产更加耐腐蚀、耐高温、等离子强度控制能力更强、更长使用寿命的产品。

3、我们注意到，公司在静电卡盘产品的产业化进程上，与陶瓷加热器存在较大的差距，是不是静电卡盘开发难度较大所致？

答：薄膜沉积设备用陶瓷加热器与刻蚀设备用静电卡盘在研发的开始时间上确实有先后。公司于 2016 年承接国家 02 专项 PECVD 设备用陶瓷加热盘的关键技术与产业化项目，距今相当于有了 9 年多的技术积累；公司于 2020 年与半导体设备客户就刻蚀设备用静电卡盘开展研发项目，距今有了 5 年多时间。在陶瓷加热器方向，公司通过承接半导体设备工厂和晶圆工厂多款研发任务，通过与客户积极配合，帮助客户解决关键部件的国产替代的困难，从而在陶瓷加热器的产业化方面取得重大突破。刻蚀设备用静电卡盘在重要性、需求量和价值量上，与陶瓷加热器比较接近，由于所用的陶瓷材料不同（陶瓷加热器一般用氮化铝，静电卡盘一般用氧化铝），其材料制备方法和工艺流程存在较大差异，但研发和生产的复杂程度也比较接近。在静电卡盘方向上，12 英寸 ICP/CCP 刻蚀机 Monopolar 静电卡盘已通过设备客户验证并小规模量产，多区加热静电卡盘已交付测试。公司继续秉承全面掌握材料配方到零部件制造

全工艺流程核心技术，拟通过发行可转债项目建设静电卡盘生产基地，打造高端功能陶瓷制造平台，使公司在静电卡盘产业化方面实现技术跃升，显著提升产品良率与综合性能指标，满足客户多规格、多场景的定制化需求。

4、公司除了通过再融资项目扩大生产外，在外延式增长，例如并购上，有没有具体计划和方向？

答：2025年7月公司收购苏州铠欣半导体科技有限公司，这是珂玛科技在并购业务上的首次尝试。苏州铠欣从事化学气相沉积（CVD）碳化硅涂层和CVD碳化硅块体陶瓷零部件研发、生产，在碳化硅陶瓷领域的产品布局和研发能力与珂玛科技现有产品体系具备较好的互补性，通过本次并购将帮助珂玛科技进一步丰富和完善碳化硅陶瓷材料和零部件领域的产品布局，形成更加全面、完整的碳化硅材料体系和半导体陶瓷零部件体系，有利于进一步提高对半导体客户的综合服务能力。目前有关苏州铠欣的整合工作，例如销售渠道、供应链管理、组织架构、信息系统等正在顺利推进中。

公司关注的项目主要涉及以下方向：

1) 围绕半导体设备零部件方向，涉及已经布局陶瓷材料，功能-结构一体模块化陶瓷产品，特殊工艺处理等，与公司现有产品在研发或技术或目标市场等形成互补；涉及其他材料成分。

2) 围绕陶瓷材料的其他应用方向。目前公司的陶瓷材料主要应用于半导体方向，在新能源、泛半导体、化工环保、生物医药、汽车、功能陶瓷等方面也有布局，但体量较小，如果在这些方向有好的项目，我们也会关注。

3) 围绕陶瓷材料的上游粉末方向，如有好的项目，公司准备在该方向做适当布局。

公司未来如有相关计划，将严格按照法律法规及相关规则，及时履行信息披露义务。

附件清单(如有)	无
日期	2026 年 1 月 9 日